****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Das congatec Computermodul mit 12-35 Watt AMD Embedded R-Series Prozessor bietet höchst leistungsfähige SOC-Grafik und HSA 2.0 Support*

**congatec integriert neue AMD Embedded R-Series SOC**

**auf COM Express**

**Satte SOC Grafik, voller HSA 2.0 Support**

**und mehr Performance schon ab 12 Watt**

**Deggendorf, 21. Oktober 2015 \* \* \*** Die congatec AG, führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer (SBCs) und Embedded Design & Manufacturing (EDM) Services, stellt parallel zum Launch der High-End Embedded Prozessoren von AMD neue COM Express Basic Module vor. Die neuen conga-TR3 Module mit Dual- oder Quadcore AMD Embedded R-Series SOCs bieten gegenüber ihren Vorgänger-Modulen nicht nur eine breiter skalierbare TDP von 12 bis 35 Watt sowie eine höhere Performance pro Watt sondern auch zwei weitere markante neue Features: Die hoch-performante AMD Radeon™ HD Grafik sowie vollen Support der HSA Spezifikation 2.0.

„Die neuen besonders grafikstarken AMD Embedded R-Series SOCs sind in einem weiten Bereich bis runter auf 12 Watt skalierbar, sodass sie sogar lüfterlose, komplett geschlossene und damit besonders robuste Designs bedienen können. Das erweitert das Anwendungsspektrum unserer High-End Embedded Module auf Basis dieser AMD Plattform erheblich“, erklärt Gerhard Edi, CTO der congatec AG.

„congatecs neue Computer-on-Module vereinfachen die Implementierung der DDR4 unterstützenden AMD Embedded R-Series SOC Prozessoren signifikant. Durch den standardisierten Formfaktor können Entwickler diese Module sofort in bestehende Applikationen integrieren und so unmittelbar von unserer neuen, besonders leistungsfähigen SOC Grafik profitieren. Die skalierbare, besonders geringere TDP ab 12 Watt sowie der umfassende HSA-Support werden uns zudem auch viele neue Anwendungsfelder erschließen“, ergänzt Scott Aylor, Corporate Vice President und General Manager bei AMD Embedded Solutions.

Anwendung finden die neuen COM Express Module von congatec in Applikationen, die eine besonders leistungsfähige, hoch integrierte Grafik und/oder parallele Rechenleistung erfordern. Diese finden sich unter anderem im High-End Gaming wie digitale Flipper- und Arcade-Automaten, in anspruchsvollen Digital Signage Installationen mit großformatigen 4k-Panels sowie der Bild- und Videoanalytik in industriellen Vision-Systemen sowie bildgebenden Verfahren der Medizintechnik. Auch Sicherheitsapplikationen wie die Videoüberwachung mit Gesichtserkennung oder Netzwerk-Firewalls mit Deep-Packet-Inspection sowie IoT-Systeme mit integrierter Big Data Analytik profitieren von der hohen GPGPU-Performance (General Purpose computing on Graphics Processing Unit) der neuen congatec Module.

**Die technischen Details**

Die neuen conga-TR3 COM Express Basic Module mit Type 6 Pinout sind mit AMD Embedded R-Series SOC Prozessoren bestückt und unterstützen bis zu 32 GB schnellen DDR4 Speicher mit optionalem ECC. Die AMD Radeon™ HD GPU basiert auf AMDs Graphics Core Next (GCN) Generation 3 Architektur und versorgt bis zu drei unabhängiges 4k Displays mit 60 Hz via eDP, DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0. Unterstützt wird zudem OpenGL 4.0 sowie DirectX 12 für schnellere, Windows 10 basierte 3D Grafik. Die integrierten Hardwarebeschleuniger ermöglichen ein energieeffizientes Streaming von HEVC Videos in beide Richtungen.

Dank HSA 2.0 und OpenCL 2.0 Support können Workloads unmittelbar der jeweils effektivsten Verarbeitungseinheit zugewiesen werden. In sicherheitskritischen Applikationen sorgt der integrierte AMD Secure Processor für eine hardwarebeschleunigte Ver- und Entschlüsselung von RSA, SHA und AES. Im Zusammenspiel mit dem optionalen Trusted Platform Modul bietet das conga-TR3 eine hohe Sicherheit für IoT-, Big Data- und Telekommunikationsapplikationen.

Die neuen Computermodule unterstützen das COM Express Type 6 Pin-Out mit PEG 3.0 x8, Gigabit Ethernet, 4x USB 3.0/2.0, 4x USB 2.0, SPI, LPC sowie I²C, SDIO und 2x UART. Betriebssystem-Support wird für Linux und Microsoft Windows 10, 8.1 und optional auch Windows 7 geboten. Umfangreiches, das Design-In erleichterndes Zubehör rundet das Angebot ab.

Verfügbar sind aktuell folgende CPU Versionen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores** |  | **L2 Cache** |  | **Taktrate  (15 W TDP)** |  | **Max. Takrate (Boost)** |  | **TDP Range** |  | **Grafik** |
| **AMD Embedded RX-421BD** |  | **4** |  | **2 MB** |  | **2,1 GHz** |  | **3,4 GHz** |  | **12/35 W** |  | **AMD Radeon™ HD R7** |
| **AMD Embedded RX-418GD** |  | **4** |  | **2 MB** |  | **1,8 GHz** |  | **3,2 GHz** |  | **12/35 W** |  | **AMD Radeon™ HD R6** |
| **AMD Embedded RX-216GD** |  | **4** |  | **1 MB** |  | **1,6 GHz** |  | **3,0** |  | **12/15 W** |  | **AMD Radeon™ HD R5** |

Das Datenblatt und weitere Informationen zum neuen conga-TR3 Computermodul unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-tr3.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliches Kernkompetenz sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*